

台灣金聯資產管理股份有限公司 函

地址：104台北市中山區南京東路二段85號
12樓

聯絡人：陳姿吟

電話：02-2568-3355 分機623

電子郵件：tzuyin.chen@tamco.com.tw

受文者：台北市不動產開發商業同業公會

發文日期：中華民國113年12月9日

發文字號：金聯資二字第1131019536號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(113P000327_11310195360_113D2000397-01.pdf)

主旨：有關本公司「雲林縣北港鎮同仁段工業用地」土地標售事宜，惠請轉發所屬會員周知。

說明：

一、旨揭土地標售投標期間自即日起至114年1月15日(三)中午12時，檢附標售資訊說明資料如附件，或可查詢台灣金聯官網<https://www.tamco.com.tw/webtamco> 標售公告。

二、惠請 貴會轉知所屬會員，把握進場時機，共創地方繁榮；如需索取資料，請逕洽聯絡人朱文慶先生，電話02-25683355分機622；行動電話:0980516113。

正本：台北市不動產開發商業同業公會

副本：電 文
交 換 章
2024/12/10 18:28:46



Pamco 台灣金聯資產管理股份有限公司

北港工業用地 113.12.1~114.1.15 公開標售 說明會



01

標售基本資料

• **土地面積 45,425坪**

◦ 甲種工業區 43,560 坪

◦ 住宅區 1,318 坪

◦ 公共設施用地 547 坪

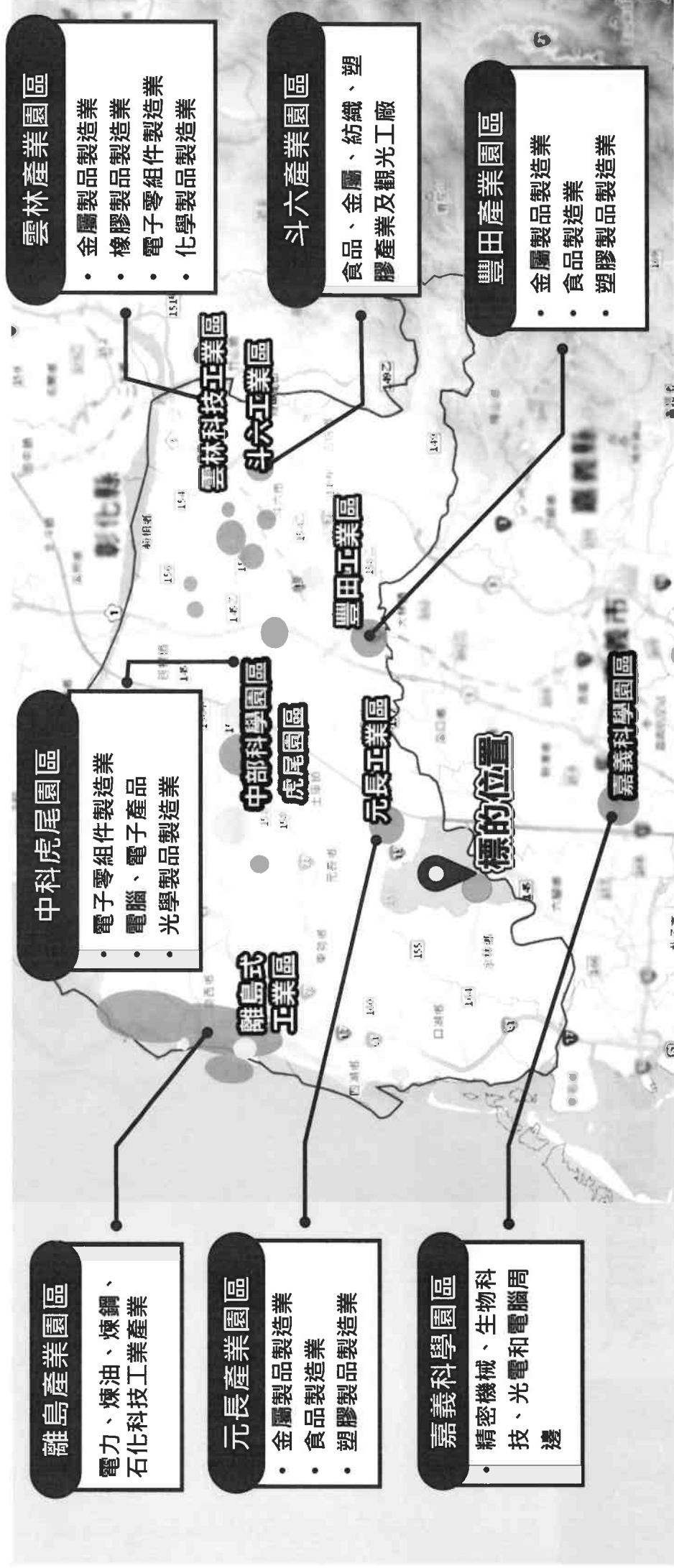
• **建物面積 794坪**

• **標售底價：新台幣 32.3 億元**

• **投標期間：113/12/01 起 45天**

- 距嘉義科學園區(台積電太保廠) 15km
- 距嘉義高鐵站 17km
- 距國道1嘉義交流道 18km

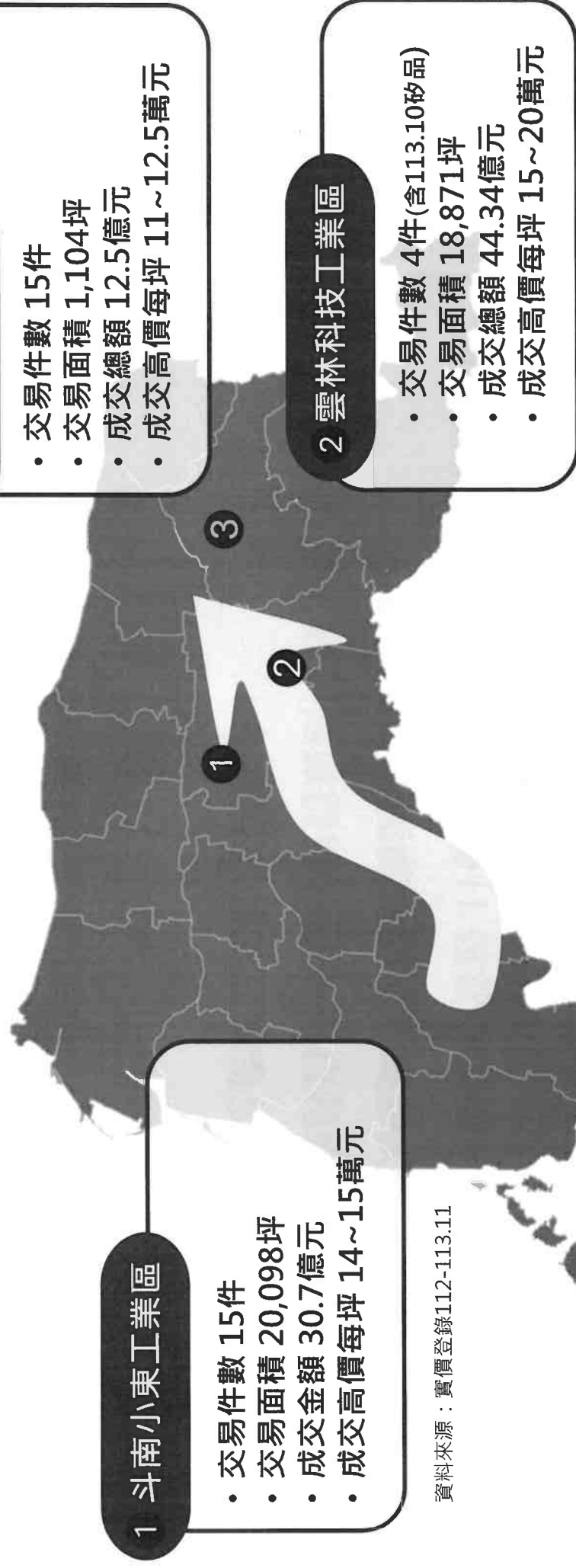




設廠亮點 具規模經濟工業用地

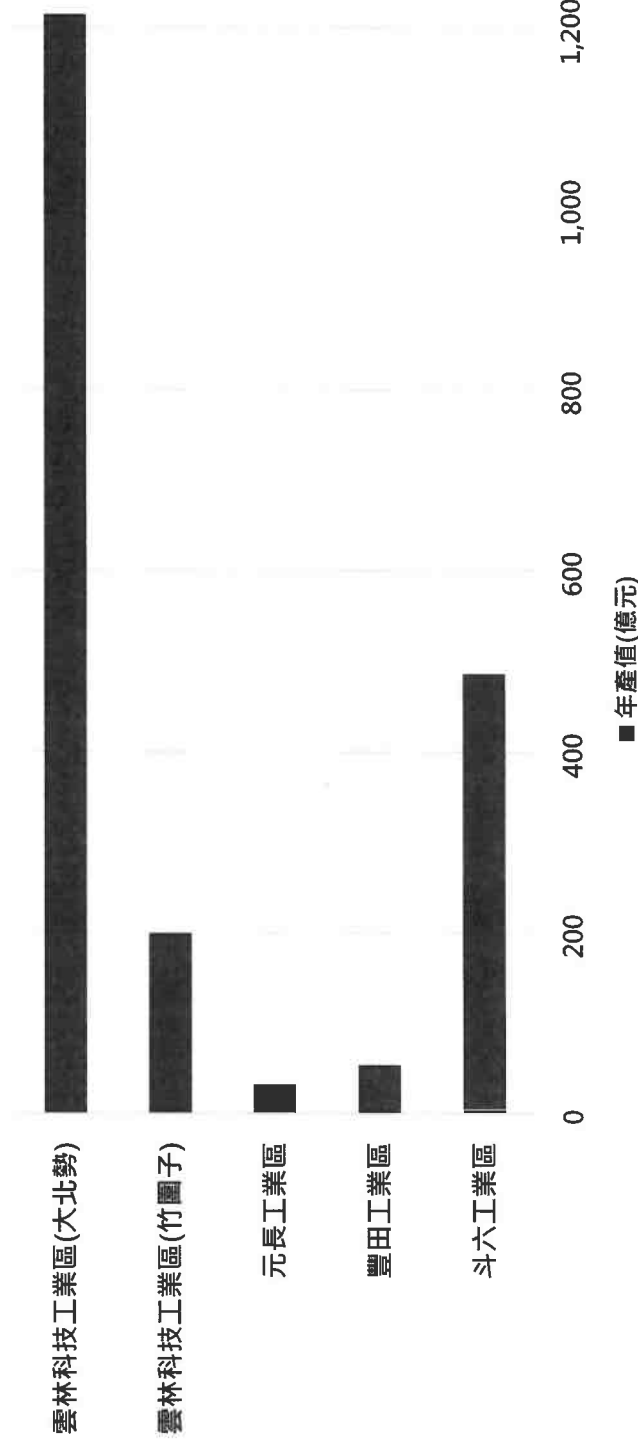
- 產權單純、面積相當於 11 個台北大巨蛋、基地完整方正
- 位於主要交通樞紐，便於物流和資源運輸
- 適合興建廠房自用或進行整體規劃開發，包含部分住宅區用地及建物，可滿足企業員工的居住需求





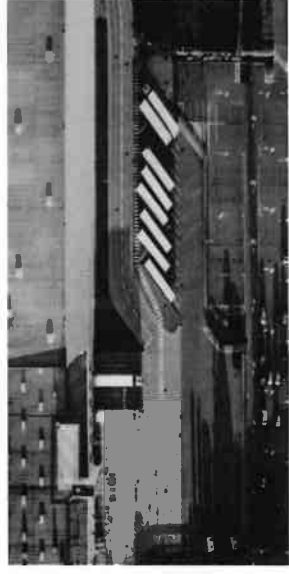
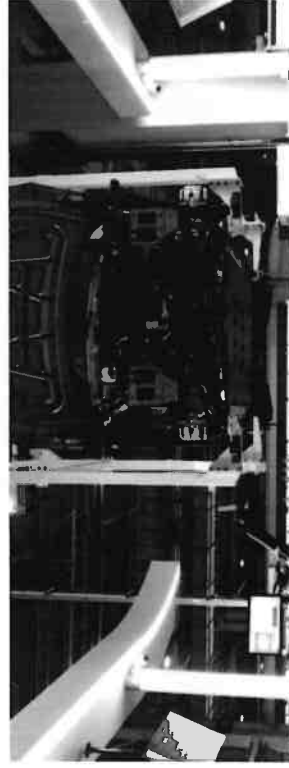
設廠亮點 發展當地產業發展

- 位居產業廊帶樞紐，可結合上下游產業進駐，產生聚落效益
- 預估可容納超過 50 家廠商，提供約 2,000 個就業機會，每年創造約 40 億元產值



設廠亮點 具半導體供應鏈進駐潛力

- 矽品精密工業擴廠進駐虎尾園區、新普設廠小東工業區、半導體封裝大廠凌嘉科技設廠雲林土庫
- 嘉義科學園區目前規劃引進台積電先進封裝廠CoWoS與 SoIC等高附加價值的事業
- 北港工業用地距嘉義科學園區15公里，具有潛力成為供應鏈的重要基地，可作為擴廠選址之一



標售達成「三要」目標

1. 繁華地方需要

- 提供2000個工作機會
- 造福1,000個家庭
- 增加住宅需求
- 促進商業活動

2. 發展產業需要

- 位居科技廊道中樞，串聯上中下游廠商，可帶動大北港產業發展

3. 台商擴廠需要

- 隨著台積電、台灣美光、日月光、矽格聯測等半導體擴大布局，滿足供應鏈需求



標售資訊

- 公告標售底價：32.3億元
- 保證金：1億元
- 標售期間：113/12/1(日) 至 114/1/15(三)中午12時
- 開標日期：114/1/15(三) 下午15時

土地位居中南部科技廊道中樞優勢

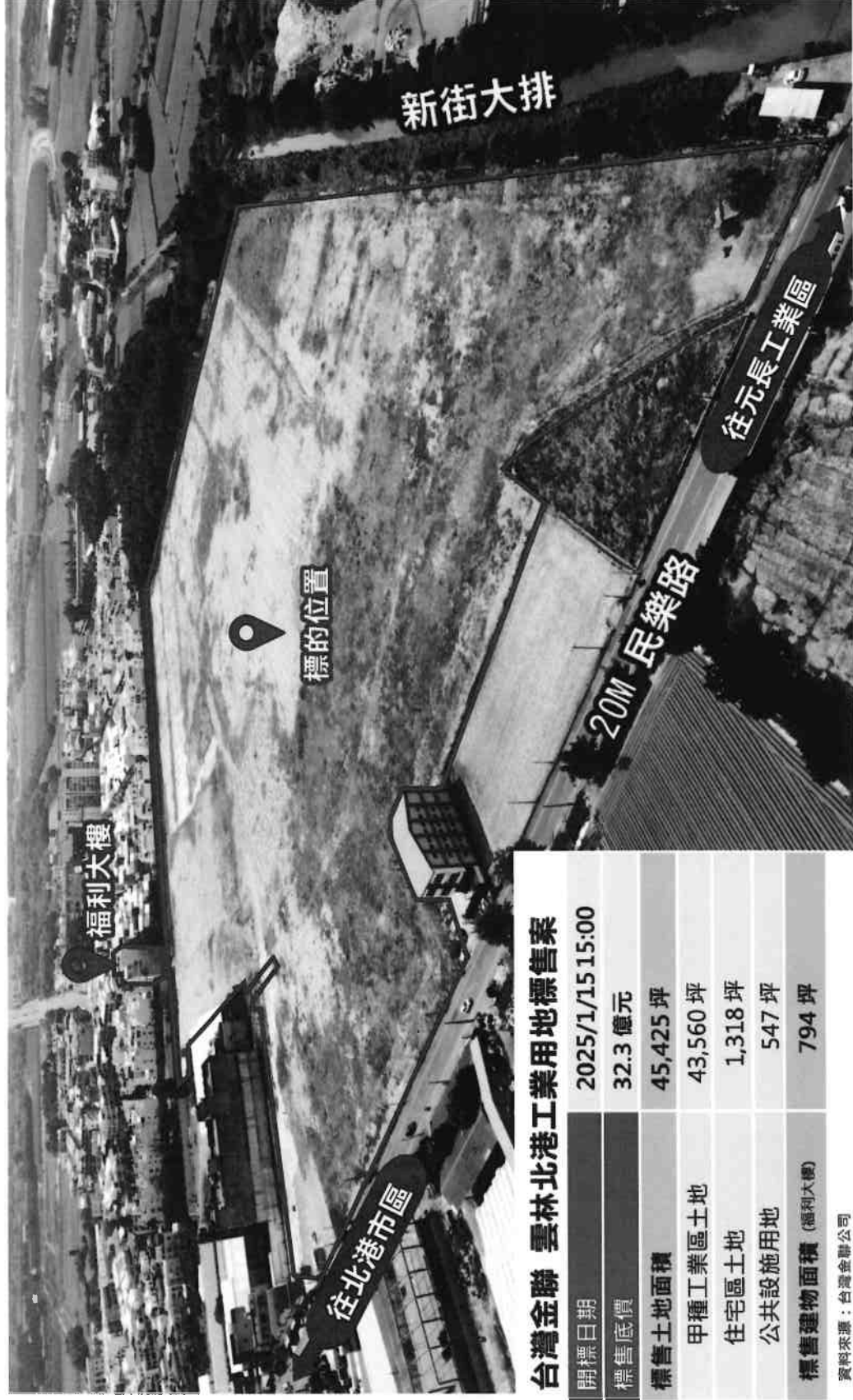
適合各產業

歡迎投標設廠



附件附圖

台灣金聯北港工業用地 全區鳥瞰圖

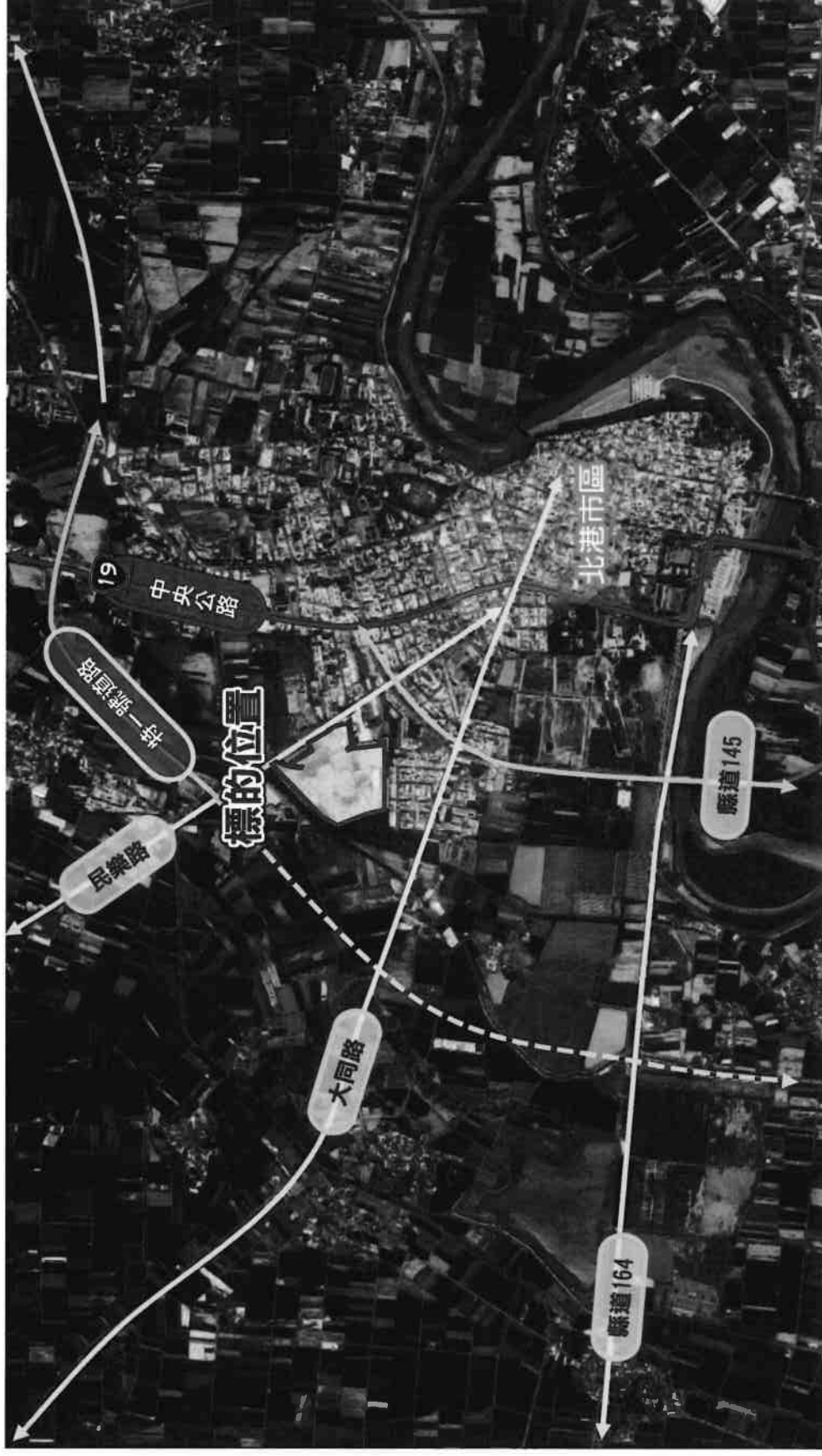


台灣金聯 雲林北港工業用地標售案

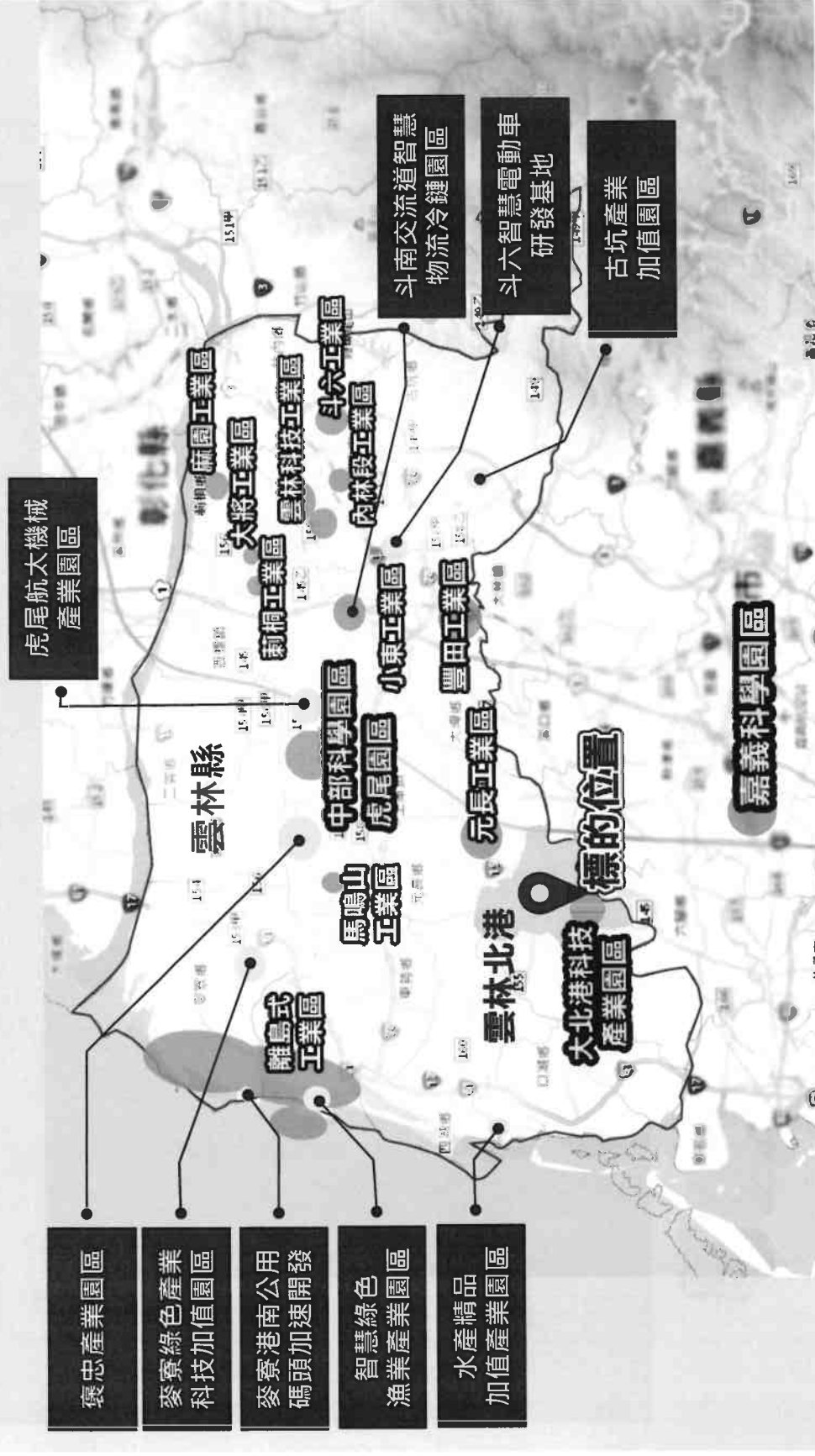
開標日期	2025/1/15 15:00
標售底價	32.3 億元
標售土地面積	45,425 坪
甲種工業區土地	43,560 坪
住宅區土地	1,318 坪
公共設施用地	547 坪
標售建物面積 (福利大樓)	794 坪

資料來源：台灣金聯公司

台灣金聯北港工業用地 位置圖



雲林縣工業區分布概況圖



鄰近北港地區 產業分布圖



台灣金聯北港工業用地 聯外交通示意圖

